MEDIENINFORMATION

ASMPT stellt Multi-Chip-Bonder-Plattform MEGA vor

Multi-Chip-Packaging mit höchster Präzision und Flexibilität

Regensburg, 6. August 2025 – ASMPT SEMI, führender Anbieter von zukunftsweisenden Lösungen für Advanced Packaging und Semiconductor Assembly, setzt mit der Multi-Chip-Bonder-Plattform MEGA Standards in Präzision und Geschwindigkeit. Die neue Geräteklasse zeichnet sich durch hohe Flexibilität, einen modularen Aufbau und geringen Platzbedarf aus. Die Version MEGA-G ist mit 12k UPH auf höchste Geschwindigkeit ausgelegt. Mit MEGA-P und einer beispiellosen Präzision von ±2 µm wendet sich ASMPT SEMI insbesondere an Photonik-Hersteller.

Die MEGA-Plattform bietet verschiedene Epoxi-Dispenser und ‑stempeloptionen, die Möglichkeit mehrere Klebstoffe parallel zu verwenden und deren Auftrag mit einer 3D-Inspektion zu überwachen. Auch die sofortige Fixierung durch UV-Aushärtung steht zur Verfügung. Picking- und Bonding-Arm arbeiten unabhängig voneinander und zwischen ihnen sitzen ein Flip-Pick-Arm und eine Rotationseinheit zur präzisen Ausrichtung.

**Flexibel auch in der Zuführung**

Mit automatischem Bondwerkzeugwechsel, bis zu zehn Bond­werkzeugpuffern und fünf Auswerfwerkzeugen passt sich die außerordentliche vielseitige Maschine schnell an neue Aufgaben an. Flexibilität beweist MEGA auch bei der Zuführung von Wafern sowie der Handhabung von Dies und Substraten. So können Dies beispielsweise auch mit Waffle Pack, Gel-pak oder über eine optionale Tape-Feeder-Station zugeführt werden. Der Multi-Chip-Bonder verarbeitet Wafer bis 12 Zoll und Dies von 0,15 × 0,15 mm bis 10 × 10 mm sowie Substrate bis zu 130 × 300 mm.

Die individuell anpassbaren Optionen von MEGA erfüllen die Anforderungen zum Packaging anspruchsvoller Multi-Chip-Komponenten und machen den Bonder zur ersten Wahl, zum Beispiel für optische Transceiver, Photonik, Sensoren und viele zukunftsweisende Anwendungen. In der Version MEGA-P kommt dazu ein patentierter High Precision Bondhead mit integrierter Optik zum Einsatz, der eine Platziergenauigkeit von ±2 µm und ±0,1º erreicht.

„Der Multi-Chip-Bonder MEGA übernimmt in einer Maschine Aufgaben, für die es früher eine ganze Linie von Maschinen erforderlich waren“, erläutert Dr. Johann Weinhändler, Regional Head ASMPT Semiconductor Solutions Europe und Geschäftsführer von ASMPT AMICRA in Regensburg, Deutschland. „Wir haben darauf geachtet, dass die Chip-Hersteller trotzdem ein Höchstmaß an Flexibilität behalten. Der modulare Aufbau ermöglicht zudem eine bedarfsgerechte Ausstattung, so dass niemand Funktion kaufen muss, die nicht benötigt werden.“

**Verfügbares Bildmaterial**

Folgendes Bildmaterial steht druckfähig im Internet zum Download bereit:   
<https://kk.htcm.de/press-releases/asmpt/>

|  |
| --- |
|  |
| **Als Die-Bonder für Hochleistungs-Rechenchips erfüllt MEGA perfekt die Anforderungen der nächsten Generation von Server-Clustern und AI-Edge-Geräten wie Smartphones, fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) sowie Daten- und Telekommunikationsanwendungen.**  Bildquelle: ASMPT |

**Über ASMPT Limited („ASMPT“)**

ASMPT mit Hauptsitz in Singapur ist weltweit führender Anbieter von Hard- und Softwarelösungen für die Semiconductor- und Elektronikfertigung. Das Angebot von ASMPT umfasst die Bereiche Semiconductor Assembly und Packaging sowie SMT (Surface Mount Technology): von der Wafer-Beschichtung bis hin zu den verschiedensten Lösungen für Assembly und Packaging empfindlicher elektronischer Komponenten in einer breiten Palette von Endverbrauchergeräten, darunter Elektronik, mobile Kommunikation, Computer, Automobilindustrie, Industrie und LED (Displays). Engste Zusammenarbeit von ASMPT mit seinen Kunden und kontinuierliche Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung tragen erheblich dazu bei, dass ASMPT innovative und kosteneffiziente Lösungen und Systeme anbietet, mit denen Anwender höhere Produktivität, höhere Zuverlässigkeit und verbesserte Qualität erzielen. ASMPT ist ein Gründungsmitglied des [Semiconductor Climate Consortium](https://www.linkedin.com/showcase/semiconductor-climate-consortium/about/).

**Mehr Informationen zu ASMPT finden Sie auf asmpt.com.**

Über ASMPT Semiconductor Solutions (“ASMPT SEMI”)

ASMPT SEMI ist der führende Anbieter von zukunftsweisenden Lösungen für Advanced Packaging und Semiconductor Assembly. Mit ihrem Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit bietet ASMPT SEMI ein umfassendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen, die den sich wandelnden Anforderungen der Mikroelektronikindustrie gerecht werden. Das Expertenwissen umfasst Bereiche wie Flip-Chip- und Wafer-Level-Packaging, fortschrittliche Verbindungstechnologien und vieles mehr. Die hochmodernen Lösungen von ASMPT SEMI ermöglichen es den Kunden, bei der Herstellung ihrer Halbleiterbauelemente eine höhere Leistung, größere Zuverlässigkeit und verbesserte Kosteneffizienz zu erzielen.

Mehr Informationen zu ASMPT SEMI finden Sie auf semi.asmpt.com.

**Pressekontakte:**

Global ASMPT Press Office  
ASMPT Ltd.   
Susanne Oswald  
Rupert-Mayer-Straße 48  
81379 München  
Deutschland  
Tel: +49 89 20800-26439  
E-Mail: [susanne.oswald@asmpt.com](mailto:susanne.oswald@asmpt.com)  
Website: asmpt.com

HighTech communications GmbH  
Barbara Ostermeier  
Brunhamstraße 21  
81249 München  
Deutschland  
Tel.: +49-89 500778-10  
E-Mail: b.ostermeier@htcm.de  
Website: www.htcm.de